

DI Corporation

Investor Relations

December 2022

본 자료에 포함된 경영실적 및 재무성과와 관련한 모든 정보는 한국 기업회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

본 자료는 미래에 대한 “예측정보”를 포함하고 있습니다.

이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무 실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다.

또한 향후 전망은 현재의 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로서 향후 시장환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료는 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 대한 법적 책임 소재의 입증자료로써 사용될 수 없습니다.



Contents



I

Corporate Overview



II

Business Area



III

Industrial Prospect



IV

New Business



Corporate Overview

1. 회 사 소 개
2. 경 영 실 적
3. 수 주 잔 고
4. 주 주 환 원



(주) 디 아 이

대표이사	박 원 호 회 장 조 윤 형 부 사 장
설 립 일	1961년 3월 16일 (1996년 7월 31일 상장)
임직원수	197명 ('22.9월말 기준)
주요사업	반도체 검사장비 및 부품 제조업
자 본 금	17,248,392,500 원
발행주식수	31,496,785 주
소 재 지	본사 : 서울시 강남구 논현로 703 디아이B/D 공장 : 경기도 화성시 삼성1로 3길 32 (동탄사업장)
홈페이지	www.di.co.kr

(주) 디지털프론티어 (*)

대표이사	오 성 구 사 장
설 립 일	2007년 1월 31일
임직원수	63명 ('22.9월말 기준)
주요사업	반도체 검사장비 및 부품 제조업
자 본 금	100,000,000 원
발행주식수	200,000 주
소 재 지	본사/공장 : 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9 엠타워지식산업센터 1301호
홈페이지	www.dfinc.co.kr

(*) 주요종속회사

(주) 디 아 이

2022.07	ESS사업부 공장 등록
2021.01	차세대 Burn-In Tester 양산기 납품 개시
2017.08	Burn-In Tester 2,000대 출하 달성
2014.02	Logic Burn-In Tester 양산기 납품
2013.05	Multi Flexibility Tester 양산기 납품
2010.12	Burn-In Tester 400호기 수출성과 달성
2007.11	제44회 무역의 날 5,000만불 수출탑 수상
2007.08	D.I China 설립 (소주 사무소)
2006.06	Burn-In Tester 세계 일류상품 선정
2006.02	'전자수출 1,000억 달러 달성' 기념 산업자원부 장관 공로패 수상
2005.11	제42회 무역의 날 2,000만불 수출탑 수상
2005.10	D.I Taiwan 설립 (신주 지사)
2005.09	제1회 대한민국반도체기술대상 최첨단기술상(국무총리상) 수상
2003.02	D.I Japan 설립 (동경 현지법인)
1996.07	기업공개 (거래소 상장)
1996.04	주식회사 디아이로 사명변경
1955.06	동일교역 설립

(주) 디지털프론티어 (*)

2021.01	경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9로 본점 이전
2019.04	SK하이닉스 기술혁신기업 선정
2018.04	ISO9001 품질경영시스템, ISO14001 환경경영시스템 인증
2017.09	고속 웨이퍼 테스터 (DF-8600) 양산기 납품 개시
2017.08	고속 패키지 번인테스터 (DF-2200) 양산기 납품 개시
2014.03	경기도 성실납세자 선정
2012.05	(주)디아이로 최대주주 변경
2008.08	반도체 검사장치 특허등록 (특허 제10-0856079호)
2008.03	기업부설연구소 설립 인가 (한국산업기술진흥협회)
2007.05	PTBI FOS-8400 발주서 수령 (구매 금액 : 49억원)
2007.04	PTBI FOS-8400 개발 장비 납품 완료
2007.01	(주)디지털프론티어 설립

(*) 주요종속회사

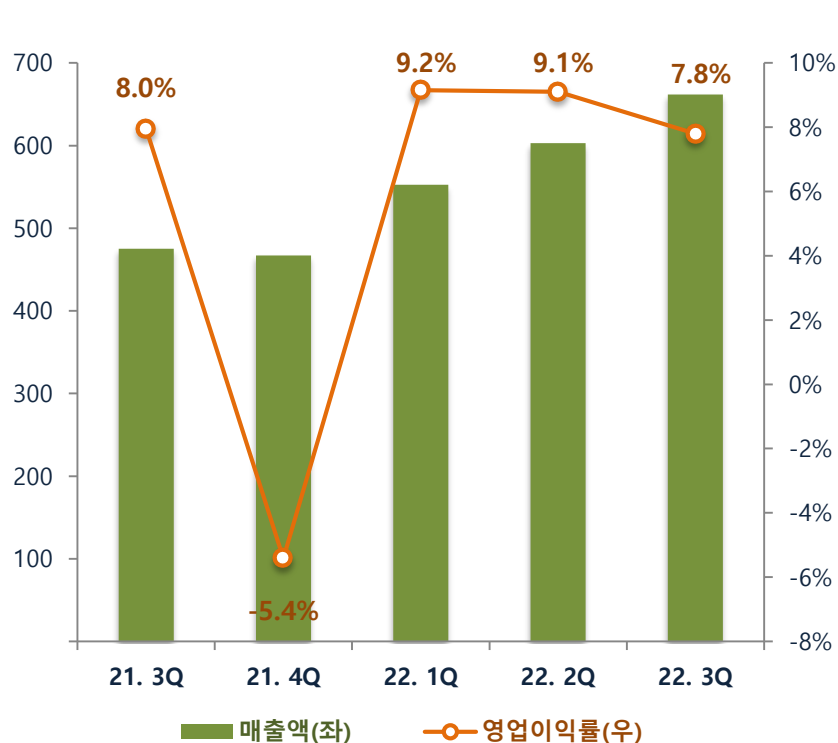
2-1. 최근 분기 경영실적

역대 최대 3분기 매출액, 연중 외형 성장 지속

· '22 고객사 활발한 투자로 3개 분기 연속 매출액 증가세

▷ 매출액: 662억 → 반도체검사장비 출하량 증가하며 QoQ +9.7% 상승

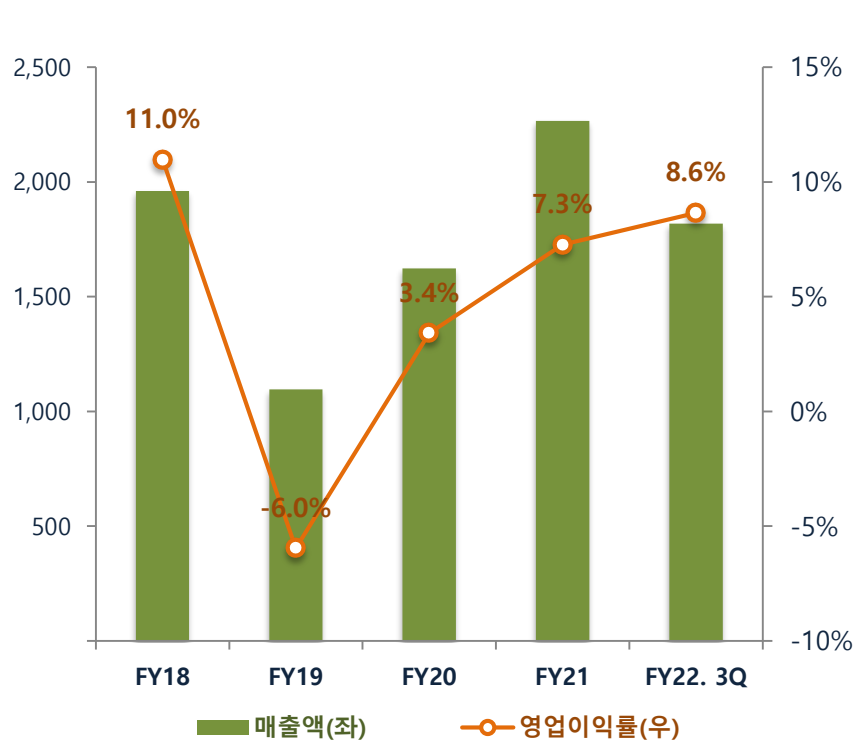
▷ 영업익: 52억 → '22년 3개 분기 연속 영업익 50억 상회



	21.3Q	21.4Q	22.1Q	22.2Q	22.3Q
매 출 액	475	467	552	603	662
반도체 장비	438	315	487	538	629
전 자 부 품	29	29	38	41	34
2 차 전 지	-	62	22	38	23
기 타	57	78	46	45	51
연 결 조 정	-49	-17	-41	-59	-75
영 업 이 익	38	-25	51	55	52

'22, 역대 최대 매출액 달성 전망

- '21 DDR5 선제 투자 개시되며 사상 최대 매출액 및 전년비 3배 영업이익 달성
- '22 DDR5 · NAND 장비투자 지속, '21 이후 1년 만에 사상 최대 매출액 경신 전망

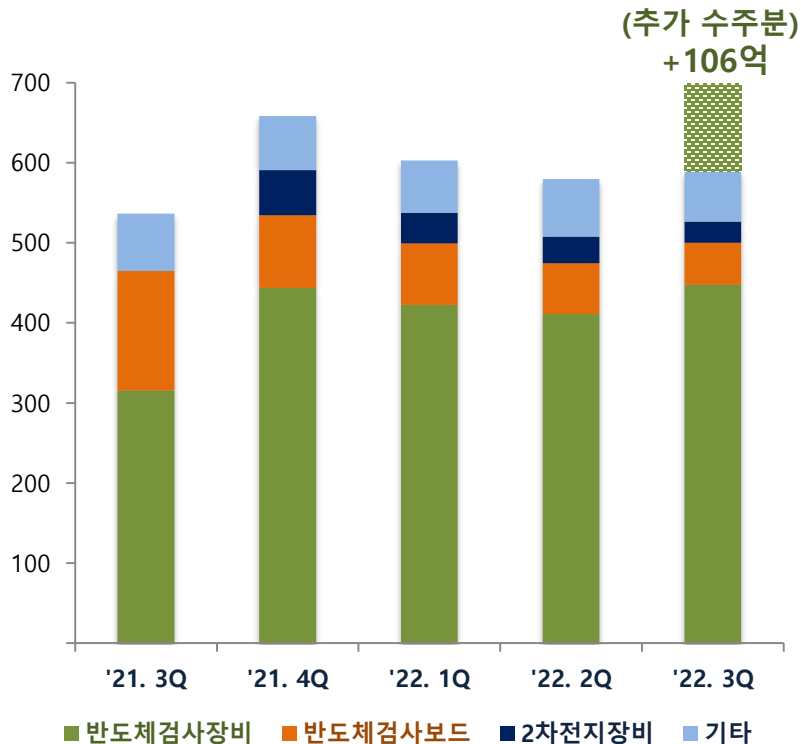


	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22.3Q
매 출 액	1,960	1,095	1,623	2,266	1,817
반도체 장비	1,860	875	1,382	2,105	1,654
전 자 부 품	200	174	149	118	112
2 차 전 지	-	-	-	62	83
기 타	65	93	201	239	92
연 결 조 정	-165	-47	-109	-259	-175
영 업 이 익	215	-65	55	165	157

3. 수 주 잔 고

106억 규모 장비 · 보드 조기 수주 ('23 공급 예정)

- '22. 3분기말 수주잔고 589억, 7개 분기 연속 수주잔고 500억원 상회
- '22. 4분기 반도체검사장비 87억 · 반도체검사보드 19억 추가 수주 공시



(단위: 억원)

부 문	21.3Q	21.4Q	22.1Q	22.2Q	22.3Q
반도체검사장비	315	444	422	411	448
반도체검사보드	150	91	77	64	52
2차전지장비	-	56	38	33	27
기 타	72	67	66	72	62
합 계	537	658	603	580	589

4. 주 주 환 원

'8년 연속 현금배당' · '자사주 10% 대규모 소각'

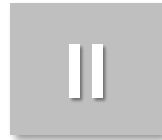
· 주주가치 제고 · 장기투자 유도를 위한 주주 환원 노력 지속

※ 과거 배당이력

사업연도	주당 배당금	액면 배당률	시가 배당률	배당성향
2021년	200원	40%	2.2%	33.8%
2020년	100원	20%	2.3%	47.5%
2019년	50원	10%	1.6%	221.4%
2018년	50원	10%	1.4%	13.8%
2017년	100원	20%	2.0%	15.7%
2016년	50원	10%	1.1%	142.9%
2015년	50원	10%	0.8%	101.3%
2014년	75원	15%	1.1%	71.6%
연속배당 횟수		평균 배당수익률		
분기(중간)배당	결산배당	최근3년	최근5년	최근8년
-	8회	2.0%	1.9%	1.6%

※ 자기주식 소각 결정

구 분	내 용
① 소각전 발행주식총수	31,496,785 주
② 소각주식수	3,196,785 주
③ 소각주식비중	10.15 %
④ 소각금액	9,151,164,364 원
⑤ 소각예정일	2022-12-14
⑥ 소각구분	자본금 감소 없는 이익 소각
⑦ 소각목적	주주 환원 및 주주가치 제고
⑧ 소각후 발행주식총수	28,300,000 주

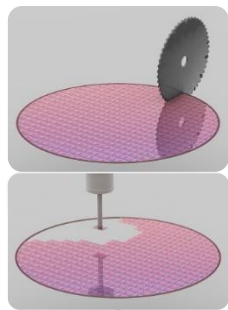
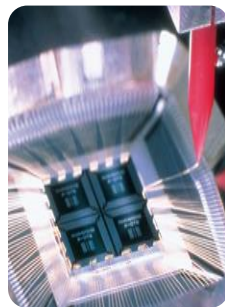


Business Area

1. 사 업 분 야
2. 제 품 현 황
3. 고 객 사

1. 사업 분야

반도체 후공정 (Back-End)

웨이퍼 절단
(Sawing)칩 접착
(Die Attach)보호 몰딩
(Molding)금속 연결
(Wire Bonding)Wafer Test

- Wafer Memory Tester
- Wafer Level Burn-In Tester
- Wafer Mother Board

Final Test

- Monitoring Burn-In Tester
- Test Burn-In Tester
- Multi Flexible Tester
- Memory Burn-In Board
- Logic Burn-In Board

- 전(前) / 후(後) 공정 Test 제품군 보유
- 장비와 보드의 Product Mix

- High Speed-Multi Tester 시장 진입
- Non-Memory Tester 영역으로 확장 中

Wafer Tester Group



Wafer Memory Tester



Wafer Level Burn-In Tester

Logic Tester Group



Logic Burn-In Tester



LED Burn-In Tester

Package Tester Group



Monitoring Burn-In Tester
(Domestic)

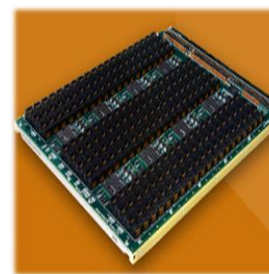


Test Burn-In Tester
(Overseas)

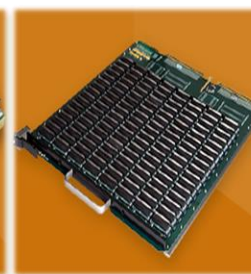


Multi Flexible Tester
(High Speed)

Boards Group



Memory
Burn-In Board



Logic
Burn-In Board



Wafer Mother Board

메모리 전공정 검사장비



- Wafer 단계에서의 성능 Test를 통한 수율 개선
 - Device: SDRAM, DRAM, NAND Flash 外
- SKH - NAND Wafer Memory Tester 공급 中
 - 기존 일본 A社 장비의 독점 영역을 침투 中
- 고객사의 국산화 정책으로
'적용범위 확장' 및 '점유율 확대' 기대

메모리 후공정 검사장비



Monitoring Burn-In Tester



Multi Flexible Tester
(High Speed)

- Package 공정 후 Cell 단위 신뢰성 Test 수행
 - Device: SDRAM, DDR, GDDR, NAND Flash, LPDDR, MCP 外
- 고속(High Speed) Burn-In 장비 양산 공급 中
- SEC - DRAM Burn-In 장비 1st 벤더 공급 中
NAND 고속 Burn-In 장비 독점 공급 中
- SKH - DRAM Burn-In 장비 2nd 벤더 공급 中
NAND 고속 Burn-In 장비 독점 공급 中

차세대 메모리 후공정 검사장비



- 고용량 · 고성능의 차세대 반도체 신뢰성 Test 장비
- Device: DDR4, GDDR6, LPDDR5, DDR5 外
- DDR5 차세대 Burn-In Tester 시장 선점 및 양산기 납품 개시 ('21. 1월~)
- '21~현재 SEC向 대규모 수주 및 1st 벤더 공급 中
- 향후 신규 CPU 플랫폼 출시에 따른 DDR5 전환을 가속화되며 지속적인 장비 공급 기대

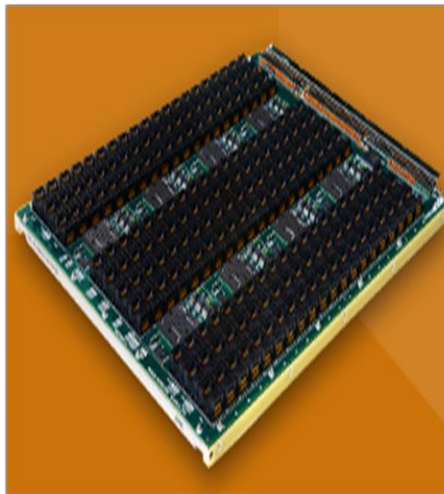
비메모리 검사장비



Logic Burn-In Tester

- Endurance Test를 제공하는 고성능 장비
- Device: DDI, SoC, Automotive, CIS 外
- 중화권 비메모리 OSAT업체에 공급 中
- SEC向 Logic Burn-In Tester 공급 中
- 증장기 국산화 Potential

반도체 검사보드



Memory Burn-In Board



Wafer Mother Board

- 고객 Needs에 따라 다양한 설계 및 테스트 제공
- Device: DDR, LPDDR, GDDR, NAND Flash, Logic 外
- SEC/SKH/해외 OSAT업체 등 다양한 고객사 확보

Memory Tester

DomesticOverseas

China



Taiwan



Powerchip

WALTON

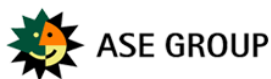
Japan



Brazil



Non-Memory Tester

DomesticOverseas

ememory

Qualcomm

ESWIN

Boards

DomesticOverseas

ememory

winbond
We Deliver

RENESAS



Industrial Prospect

1. D R A M

2. N A N D

신규 플랫폼 출시에 따른 DDR5 침투 본격화

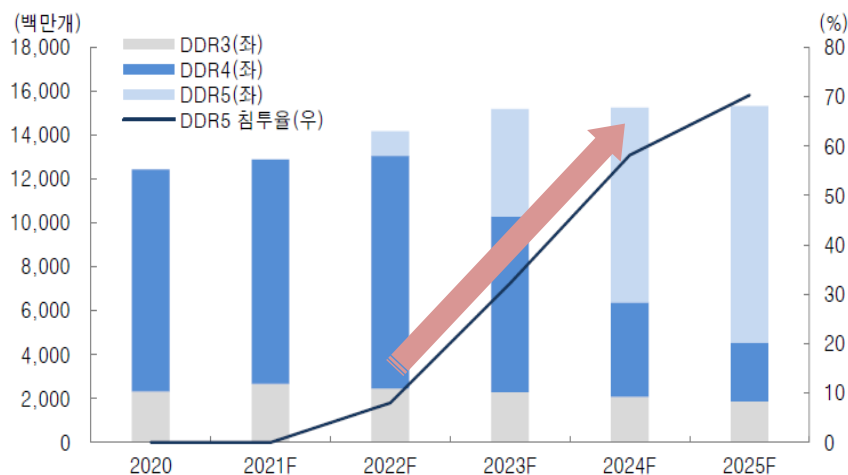
· Intel · AMD는 '23년 초 DDR5 DRAM이 탑재되는 Server용 차세대 CPU 출시 예정

▷ Intel : Sapphire Rapids (Server) → '22.2Q 초도 물량 출하 시작, '23.1Q 공식 출시 예정

▷ AMD : Genoa (Server) → '22.4Q 공식 출시

· DDR5 침투 효과 및 고객사의 초격차 전략으로 차세대 검사장비 수혜 · 구조적 성장 전망

[DDR5 침투율 전망]



자료: Omdia, 대신증권 리서치센터

[서버용 Processor 스펙]

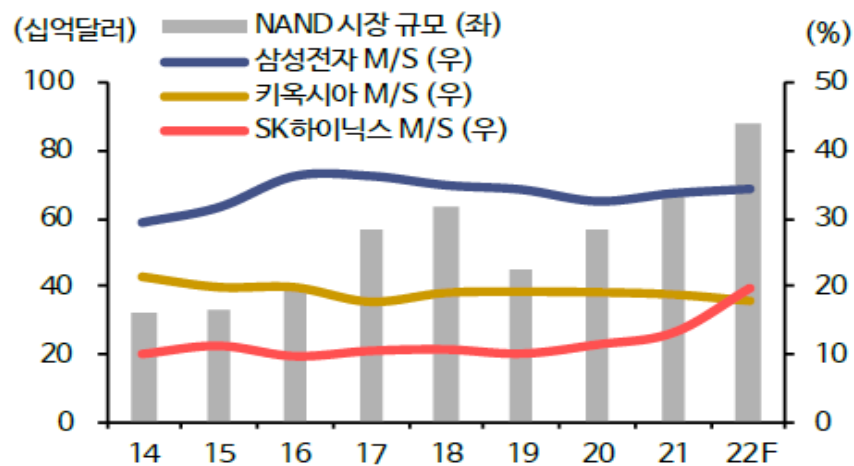
업체명 코드명	Intel		AMD	
	Ice Lake	Sapphire Rapids	Milan	Genoa
출시날짜	1Q21	2Q22	1Q21	3Q22
Fabrication Node	10nm	10nm	7nm	5nm
Microarchitecture	Sunny Cove	Golden Cove	Zen 3	Zen 4
Max Core 개수	40	40	64	96
Socket	LGA4189	LGA4677	LGA4094	LGA6096
Memory Support	DDR4	DDR5	DDR4	DDR5
Pcie Gen	PCIe 4.0	PCIe 5.0	128 Gen 4	128 Gen 5
Processor 세대	3세대	4세대	3세대	4세대

자료: 언론 자료, 신한금융투자

고단화 NAND 시장 선점 경쟁 심화

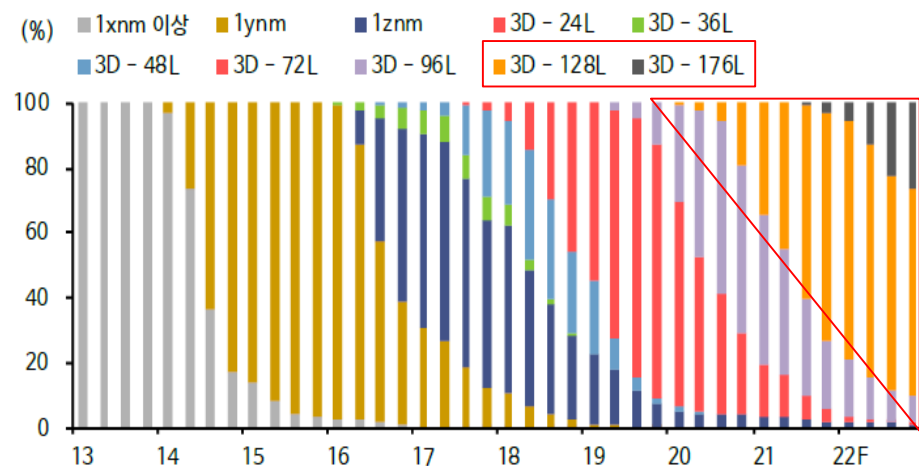
- SK하이닉스의 Intel NAND 사업 인수로 Enterprise SSD M/S 확대 기대
- 고단 NAND 양산 · 수율 확보 및 시장 선점을 위한 NAND 장비 투자 재개 전망

[NAND 시장 순위 및 M/S]



자료: 신한금융투자 추정

[SKH 3D NAND 단수 비중 추이]



자료: DRAMeXchange, 신한금융투자 추정

IV **New Business**

1. 타법인 주식 취득 관련 사항

디아이, 2차전지 장비 신규사업 진출

- 新 성장산업인 2차전지 시장으로의 신규사업 진출
- 반도체 장비사업에서 축적된 노하우를 활용하여 2차전지 장비사업에 대한 시너지 창출
- 회사의 중장기 미래 성장동력으로 육성할 계획

[회 사 개 요]

회 사 명	(주)디아이비
대표이사	반 지 혁
주요사업	2차전지 공정자동화 장비 제조업
설 립 일	2021년 6월 28일
자 본 금	1,000,000,000 원
최대주주	(주)디아이
지 분 율	51.0%
관 계	연결대상 종속회사

회 사 명	(주)브이텐시스템
대표이사	한 규 범
주요사업	2차전지 머신비전시스템 SW/검사장비 제조업
취 득 일	2021년 10월 28일
자 본 금	1,000,000,000 원
최대주주	(주)디아이
지 분 율	60.0%
관 계	연결대상 종속회사

회 사 명	(주)프로텍코퍼레이션
대표이사	이 근 중
주요사업	2차전지 비전검사장비 제조업
취 득 일	2022년 3월 30일
자 본 금	175,000,000 원
최대주주	(주)디아이
지 분 율	57.1%
관 계	연결대상 종속회사



서울시 강남구 논현로703 | 02-546-5501 | www.di.co.kr